

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于对外投资暨对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海新阳电子化学有限公司（以下简称“新阳电子化学”）是上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“公司”）的全资子公司，公司持有新阳电子化学 100%的股权。

为了加速公司在半导体晶圆级封装领域的业务发展，进一步提高公司综合竞争力和持续发展能力，促进经营效益提升，公司拟对子公司新阳电子化学进行增资，同时引入新股东投资方，具体情况如下：

（1）2016 年 3 月 4 日，上海新阳和硅密四新半导体技术（上海）有限公司（以下简称“硅密四新”）就合资经营事宜签署了《晶圆级封装湿制程设备项目合作投资协议》（以下简称“《合作投资协议》”）。

根据《合作投资协议》约定，双方对新阳电子化学共同进行增资。增资完成后，新阳电子化学名称拟变更为“上海新阳硅密半导体技术有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“标的公司”），注册资本变更为 2000 万元人民币。上海新阳出资 900 万元人民币（含新阳电子化学原账面资金 300 余万元），持有 45%的股份；硅密四新出资 1100 万元人民币，拥有 55%的股权，标的公司成为公司的参股子公司。

（2）2016 年 3 月 10 日，本公司第三届董事会第二次会议审议关于《上海新阳半导体材料股份有限公司与硅密四新半导体技术（上海）有限公司合资经营并共同向子公司上海新阳电子化学有限公司增资及签署〈合作投资协议〉的议案》，公司 9 名董事参与表决且一致同意该项议案，该事项自董事会审议通过后开始实施。本次对外投资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

(3) 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他股东方介绍

合资股东：硅密四新半导体技术（上海）有限公司

成立日期：2011 年 6 月 9 日

注册地址：上海市徐汇区龙华路 2577 号 27 幢 123 室

企业类型： 有限责任公司（国内合资）

法定代表人：印琼玲

注册资本： 20 万元

主营业务： 太阳能，半导体、电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询（除经纪）、电子产品、机电设备、太阳能设备、环保设备及配件的销售，从事货物进出口与技术的进出口业务

股东构成：

股东种类	股东名称	出资金额	出资比例
有限责任股东	印琼玲	12 万元	60%
有限责任股东	印玉弟	8 万元	40%
	合计	20 万元	100%

上述当事人与上海新阳及其控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：上海新阳硅密半导体技术有限公司（暂定名，以工商登记为准）

公司性质： 有限责任公司

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：上海市松江区思贤路 3600 号

经营范围：半导体湿制程设备的研发、生产、翻新。（最终以工商局核准的经营范围为准）

2、标的公司的股权结构

标的公司注册资本为 2000 万元人民币。其中：上海新阳出资 900 万元人民币（含新阳电子化学原账面资金 300 余万元），持有 45%的股份；硅密四新出资 1100 万元人民币，拥有 55%的股权。具体股权结构见下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	上海新阳半导体材料股份有限公司	900	45%
2	硅密四新半导体技术（上海）有限公司	1,100	55%
注册资本总额		2,000	

3、本次投资的相关情况

本项目由上海新阳半导体材料股份有限公司和硅密四新半导体技术（上海）有限公司共同投资发起，两个投资方共同向上海新阳电子化学有限公司增资，并拟将其更名为“上海新阳硅密半导体技术有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。

标的公司由两个投资方共同增资组建，注册资本 2000 万元人民币，将打造成为一家专业的半导体设备研发、设计、制造、服务的公司，在中国半导体产业高速发展的大背景中，从事并专注于产品和服务创新、国际水平的半导体设备制造业务以及杰出运作，将立足于市场的关键需求和先进的自主产权，全力打造亚洲唯一完整的半导体湿法设备与化学药液一体化的技术平台，为前段、中段、后段半导体生产客户提供完整的一站式工艺、设备及技术服务，并逐步发展为半导体行业国际化龙头公司。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同当事人

甲方：上海新阳半导体材料股份有限公司

乙方：硅密四新半导体技术（上海）有限公司

（二）合同主要条款

1、合作方式

本协议生效后于 2016 年 12 月底之前，双方共同出资，完成“上海新阳电子化学有限公司”的公司重组事宜（1、增资至 2000 万元人民币；2、组建新的董

事会，管理团队，技术团队；2、变更经营范围，变更公司名称，初步拟为“上海新阳硅密半导体技术有限公司”，以下简称“新公司”，具体以工商登记为准；)；后期总投资追加至2亿（贰亿）元人民币，甲乙双方按股权比例追加或新公司自筹，或引进第三方投资者，具体由新公司董事会另行决定。

2、标的公司注册资本及双方的出资额、出资比例

新公司的名称、宗旨、经营范围以工商登记为准，新公司的注册资本为2000万元人民币；其中，甲方认缴出资900万元人民币（含新公司重组前账面资金300余万元），持有新公司45%股份，乙方认缴出资1100万元人民币，持有新公司55%股份。出资人以各自的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

3、标的公司的组织结构

标的公司最高权力机构为董事会，董事会设4人，甲方占2席，乙方占2席，董事长、法定代表人由甲方推荐的人担任；董事任期三年，可以连任。委派董事的一方可随时撤换该董事并委派替任人选；

标的公司设独立监事，设总经理，设技术总监，皆由乙方推荐的人担任

标的公司的管理团队和技术团队由乙方负责组建；

标的公司的财务负责人，由甲乙双方共同推荐。

4、知识产权保护

双方同意，本协议生效期间，各方（项目参与人的直系亲属，项目参与公司的股东、董事、经理、监事、高管、子公司、下属控股企业等）在中国大陆不得与任何第三人或组织进行与本协议相同产品的合作；但传统封装及化学药液业务仍属甲方，乙方现有业务仍属于乙方，新开展业务属于新公司。

双方承诺自己100%拥有所提供的技术及客户资源，不存在知识产权纠纷问题，也不存在侵犯任何第三人的知识产权。一旦出现知识产权纠纷，所有的责任与后果均由提供方承担。

5、合同生效条件和生效时间

本合同于2016年3月4日由双方共同签署，在获得上海新阳董事会批准后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

发展半导体晶圆级封装湿制程设备制造和翻新业务，同时融合半导体湿法设备与化学药液材料两大方面的创新先进技术，打造完整的一体化技术服务平台，为前段、中段、后段半导体生产客户提供完整的一站式工艺、设备及技术服务，逐步发展为半导体行业国际化龙头公司。

2、存在的风险

（1）市场竞争风险

全球装备产业整合加速，装备产业形成强者恒强的格局，市场垄断和技术壁垒是国产设备的无法回避的问题。外国知名半导体设备企业在华加大投资力度，争抢高端技术人才，降低运营成本和抢占中国市场。与外国半导体设备制造企业相比，中国国产半导体设备制造水平低，市场影响力相对小，面临市场竞争的风险。

本项目立足于国内市场，充分发挥各投资方已有的客户资源优势和市场影响力，借助国家产业政策的大力支持，以及本土化供应的成本优势和效率优势，积极进行市场开拓，与客户形成良好的互动关系，最大程度的降低市场竞争风险。

（2）技术风险

本项目的目标是开发两大类设备：300mm 批量式清洗机与 300mm 单片电镀机。每一类设备的研制都是一个巨大的挑战，面临一定的技术风险。

我们把平台定位在中后段上避免了部分技术难关，充分发挥我们已有的经验，借助投资方原有的技术积累和先进的技术平台，组建一支具有较强工艺及设备研制能力的技术团队，建立目前亚洲唯一的晶圆电镀工艺实验室，能够完成研发、小试、中试并模拟客户现场进行工艺实验，同时积极寻找更多的合作伙伴，不断完善核心技术提升竞争优势。

（3）投资项目无法实现预期收益的风险

半导体行业设备更换周期相对长，应用认证时间长。虽然公司在决策过程中综合考虑了各方面的情况，为投资项目作了多方面的准备，但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化以及客户开发、产品市场销售状况等变化因素的影响。如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力，公

司将会面临投资项目无法达到预期收益的风险。

公司将组建专业项目团队，确保资金及时到位，制定周密的项目实施方案，积极争取国家产业扶持政策，尽力确保项目顺利实施并达到预期收益。

3、对公司的影响

本项目的实施有助于增强上海新阳在半导体晶圆级封装领域的市场竞争力，形成在晶圆级封装领域材料和设备的配套优势，进一步提升上海新阳在半导体行业的影响力，具有良好的经济效益和社会效益。

六、备查文件

- 1、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第二次会议》
- 2、《晶圆级封装湿制程设备项目合作投资协议》
- 3、《晶圆级封装湿制程设备项目可行性研究报告》

特此公告

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2016年3月10日